



Ball-Wedge Bonder 5610

Bond System

Drahttypen	Golddraht 17,5-50µm auf 2"-Spule (Optional Kupferdraht-Kit)
Bondkopf	Ball-Wedge für Golddrähte Standardkapillare 16mm Länge (optional 19mm)
Ultraschall System	F&S Generator 67kHz (optional 120, 140kHz)

Maschinen Basis

Achsen	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsbereich X/Y-Achse 100x100mm Z-Achse 60mm Schrittauflösung 0,25µm Wiederholgenauigkeit <2µm
Hardware	<ul style="list-style-type: none"> Dual Core PC, 1,6 GHz Prozessor, 4 GB RAM, Ethernet, 4x USB-Hub Front Firewire CCD Farbkamera 1,4 MPixel Netzwerkfähig mit TCP/IP Server zur
Software	<ul style="list-style-type: none"> Einzelbonds bis komplexe Programme, Loopformen in Bibliotheken speicherbar Optionale Bilderkennung
Geschwindigkeit	20 Drähte ≤ Minute
Abmessung	B x T x H – 70 x 65 x 70 cm, Gewicht ca. 80kg
Anschlüsse	100-240 VAC, 1 Phase, 50/60 Hz, max 500 VA Ø 6mm Standard-Vakuumschlauch
Heizung	Steuerung in der Maschine integriert 0-250 °C

Die 56xx Serie:

Der semiautomatische Gold-Ball-Bonder 5610 ist auf Basis der 56xx-Serie voll PC-gesteuert und es sind beliebig viele Bonds oder Bumps programmierbar.

Die programmierten Zielpunkte werden über das Kamerazielfadenkreuz angefahren und die programmierten Bonds oder Bumps werden automatisch gebondet.

F&S Bondtec bietet bei dieser Maschine zwei Modis an: Singlebond zum Reparieren von div. Bond-samples und zum Setzen von Einzelbonds (manuell oder automatisch) und Multiwire zum Teachen und Bonden von Chips oder div. Bond-samples (semi- und vollautomatisch).

Durch einfachen Wechsel der Bondköpfe und der Software kann diese Maschine auch auf Dünndraht Wedge-Wedge oder Dickdraht Bonder umgerüstet werden. Ebenso ist die Maschine als Pull-/ Shear-tester einsetzbar.

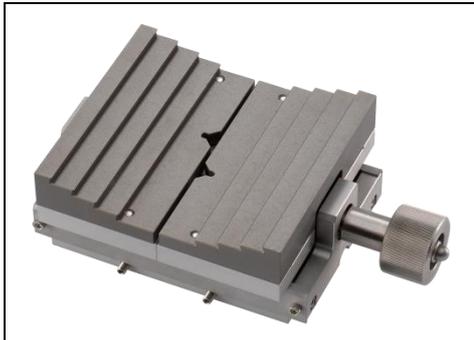
Werkzeugloses Umrüsten ist in ca. 3 Minuten möglich!

Substrathalter

Standard-Substrataufnahme
für Bauteile bis 4x4" mit
Vakuum und mechanischer Klemmung



Optional:



Substrathalter 4x4"
mit Stufenbacken



TO Aufnahme mit
mechanischer Klemmung



4x4" Substrataufnahme m.
gummierter Oberfläche, mit
mechanische Klemmung

F&S Bondtec Semiconductor GmbH

Industriezeile 49a

A-5280 Braunau am Inn

Tel.: +43-7722-67052-8270

Fax: +43-7722-67052-8272

Mail: info@fsbondtec.at

Web: www.fsbondtec.at

Hilpert
electronics

Ihr Vertriebspartner/ Votre représentant:

Hilpert electronics AG
Täferstrasse 29
5405 Baden-Dättwil
Schweiz / Suisse

Tel: +41 56 483 25 25
Fax: +41 56 483 25 20
Mail: office@hilpert.ch
Web: www.hilpert.ch

